

## 安徽耐科装备科技股份有限公司

证券简称：耐科装备      证券代码：688419      编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	国联民生证券 周晓萌 南土资产 王 可 鹏扬基金 许颖婕 太平养老保险 张 凯 中银基金 张欣仪
时间	2026年01月21日
地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：黄戎、董事会办公室职员：刘胡洁
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、会议交流（会议交流内容如下）</b></p> <p>1、简单介绍企业情况</p> <p>公司成立于2005年10月份，从挤出成型装备产品制造开始起步，产品一直做到细分行业世界前列位次。随着公司新厂区的建设并投入使用，2014年公司开始策划进军半导体封装装备行业，经过市场调研，2016年半导体封装设备正式投入研发，2018年手动半导体封装设备开始投入市场，2020年前后公司在半导体封装装备行业主打产品全自动封装设备全面推向市场。目前，公司的业务包括两大块，半导体封装装备和挤出成型装备，其中半导体封装装备以国内销售为主，目标是实现进口替代，已与通富微电、长电科技、华天科技、比亚迪半导体等国内头部半导体封装知名企业建立合作关系，公司正逐步开拓境外半导体封装装备客户，目前已成功与</p>

东南亚安世、英飞凌半导体等客户建立合作。挤出成型装备以出口为主，产品远销全球 40 多个国家和地区，服务 400 余家国外客户，服务于欧美等众多全球著名品牌，出口规模连续多年位居我国同类产品首位。

2、公司对两类业务后续资源投入及业务重心的规划

半导体装备是公司未来主要发展方向，将继续加大研发和投入，提高产品技术水平，特别是压塑成型装备的开发；在挤出成型装备业务领域将不断进行技术升级，努力提高海外高端市场占有率。

3、目前来看压塑成型装备和注塑成型装备市场占比？

现没有准确数据，据了解注塑成型工艺装备市场相对较大，压塑成型工艺是未来发展方向，采用压塑成型工艺的设备主要为晶圆级、板级封装装备，但晶圆级和板级封装装备的国产化还是空白，市场目前主要被国外设备厂商垄断。目前公司设备为转注成型工艺为主，现公司正在研发的基板级封装装备和晶圆级封装装备为压塑成型工艺设备，以期早日在产业化生产中实现进口替代。

4、公司目前研发的压塑封装的产品有哪些，处于什么阶段？

公司目前涉及压塑工艺封装装备研发项目有三项，100mm×300mm 基板类封装装备、320mm×320mm 大尺寸板级封装装备及晶圆级封装装备采用压塑工艺，其中 100mm×300mm 基板类封装装备近期将发往客户端测试试用并完善。

5、半导体封装装备的交货期？

半导体封装装备为定制化产品，产品结构不同，技

术参数不同，制造加工周期也不同。根据客户需求生产，以公司半导体全自动封装设备 180T 一拖四标准化产品为例，一般交货周期为 6 个月左右。

6、公司半导体封装装备和日本相关设备在技术上有什么区别？

在半导体塑封封装装备领域，目前主要采用两种工艺方式进行工作，分别是转注成型工艺和压塑成型工艺，转注成型工艺装备我公司技术已成熟，部分技术指标已达到国际先进水平，参数与日本相关设备没太大差距，但是在稳定性方面稍逊；压塑成型工艺装备目前国内未听说有产业化成果，本公司也一直在此方面进行研发攻关，近期有 100mm×300mm 基板类封装装备将发往客户端测试试用并完善。

7、三大封装厂客户采购的设备中耐科装备的占比情况？

三大封装厂都是公司的主要客户，与公司是长期合作关系，但客户的设备采购是客户的商业秘密，无相关数据。

8、从客户下单情况来看，相对于去年的增速大概怎样？

目前公司订单充足，以公司半导体全自动封装设备 180T 产品为例，每年可出货 35-40 台（套）。随着 2025 年 12 月公司募投项目半导体封装装备新建项目结项并投产使用，预计 2026 年产能将逐渐释放，年出货量也随之增加。

9、市场景气度怎么样？

从公司市场部了解到，目前下游客户封装厂大部分处于满产状态，有很多客户皆有扩产意愿。

10、基板类封装装备样机到客户端需要验证多久？

	<p>验证时间目前不好进行预测。</p> <p><b>二、现场参观</b></p> <p>现场参观了两类业务研发现场及制造车间，观看了采用压塑成型工艺的基板类封装装备及板级/晶圆级封装装备样机。</p>
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2026年1月22日